รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาในการบัดกรีกับการเกิดสารประกอบเชิงโลหะในรอยบัดกรีของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-58Bi กับแผ่นรองทองแดง

A study on relationship between soldering temperature and time and the formation of intermetallic compounds of Sn-58Bi lead-free solder and Cu substrate

นายกรรณชัย กัลยาศิริ

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาในการบัดกรีกับการเกิดสารประกอบเชิงโลหะในรอยบัดกรีของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-58Bi กับแผ่นรองทองแดง

A study on relationship between soldering temperature and time and the formation of intermetallic compounds of Sn-58Bi lead-free solder and Cu substrate

นายกรรณชัย กัลยาศิริ

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง